

伯東、アジア最大級のエレクトロニクス開発・実装展 ネプコンジャパン 2026 に出展

伯東株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長執行役員：宮下環、証券コード 7433、以下 当社）は、2026 年 1 月 21 日(水)～23 日(金)に東京ビッグサイトにて開催される「ネプコンジャパン 2026」に出展いたします。

当社ブースでは半導体後工程向けを中心としたパワーモジュール/MEMS/センサ実装用の製造・試験装置を始め、プリント基板や FPD、リチウムイオン電池の製造などに寄与するステッパー／露光装置やクリーナー、温度環境試験装置等を実機とパネルにてご紹介致します。また、株式会社クリアライズの受託分析サービスもパネルにてご紹介いたします。

当展示会にご参加の際は是非当社ブースへお立ち寄りいただきたく、心よりご来場をお待ち申し上げます。



伯東株式会社

第40回 **インターネプコン ジャパン**
エレクトロニクス製造・実装展

【ネプコンジャパン 2026 開催概要】

会期・時間：2026 年 1 月 21 日(水)～23 日(金) 10:00～17:00

開催場所：東京ビッグサイト 東展示棟 2 ホール（ブース No. E10-24）

来場登録：

<https://www.nepconjapan.jp/tokyo/ja-jp/register.html?code=1552775375790401-AU2>

【展示製品】

《代理店製品群》

■独・centrotherm international AG

- ・ バッチ式開発・試作・小規模量産用 小型真空リフロー炉
- ・ バッチ式量産用 大型真空リフロー炉

■米・inTEST Thermal Solutions

- ・ 低温・高温 IC テストハンドラー用温度制御ユニット
- ・ 温度環境試験機

■台・Symtek Automation Asia

- ・ ファクトリーオートメーションシステム

■東洋熱工業株式会社

- ・ 2 流体ジェットクリーナー/ドライクリーナー

《当社製品群》

■全自動インライン式真空リフロー装置

- ・ 連結増設可能モジュールタイプ HVR-1

■パワーデバイス、パワーモジュール用シンタリング（焼結接合）装置

- ・ 試作・開発用シンタリング装置
- ・ 量産用・全自動シンタリング装置

■半導体パッケージ製造装置

- ・ ハイエンドパッケージ基板対応モデル ドライフィルムオートカットラミネータ Mach510PK
- ・ 高解像／高精度投影露光装置 LS-320HR/LS-300EX

《グループ会社》

■株式会社クリアライズ

- ・ 受託分析試験サービス

伯東株式会社

(<https://www.hakuto.co.jp>)

伯東は1953年の創業以来、最新の情報や最先端の技術をいち早くお客様へお届けする技術商社として、生産の効率化を図る工業薬品を生み出すメーカーとして、皆様のご愛顧とご支援により順調な発展を遂げてまいりました。

伯東は、「人と技術で広く世界を結ぶ」をモットーとし、先進のテクノロジーで産業社会の未来を切り拓くため、最適なソリューションを提供してまいります。また、エレクトロニクス×ケミカル領域、商社×メーカーのハイブリッド企業としてのシナジーを発揮し、独自の価値を創出してまいります。

本件に関するお問い合わせ先

システムイノベーションカンパニー

半導体・科学ソリューション営業部

TEL：03-3355-7645
